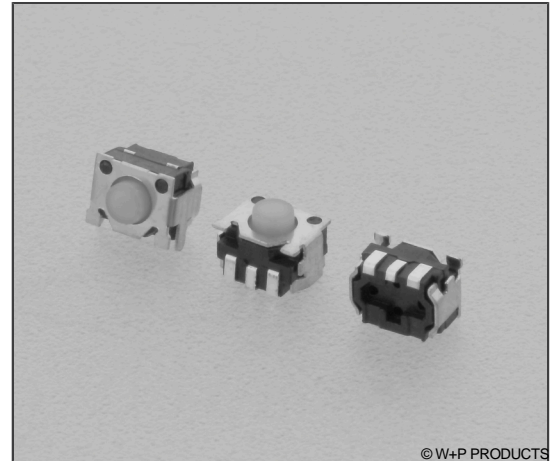


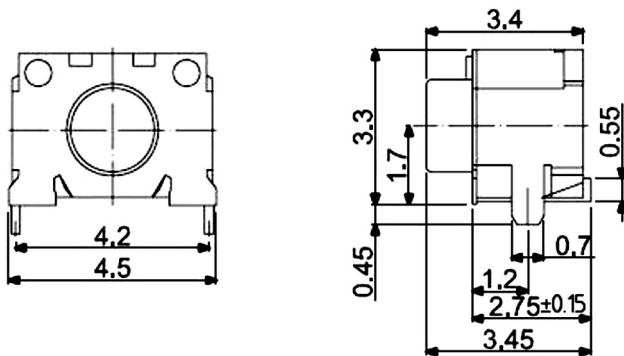
SMT-Mini-Taster, 4,2x3,3mm, stehend, Bauhöhe 3,4mm SMT Mini Tactile Switches, 4.2x3.3mm, vertical, 3.4mm Profile

Technische Daten / Technical Data

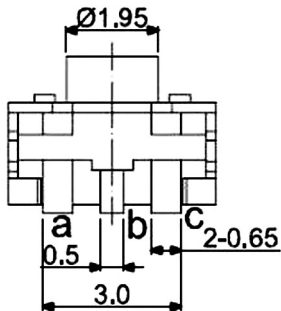
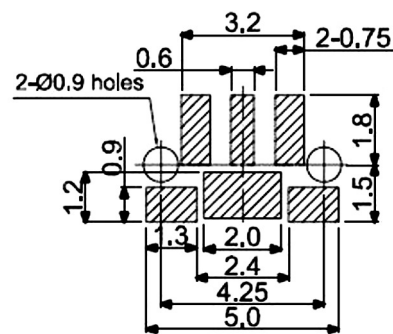
Gehäuse/Abdeckung/Hebel <i>Case/Cover/Actuator</i>	Thermoplast/Stahl/Thermoplast, UL94 HB <i>Thermoplastic/Steel/Thermoplastic, UL94 HB</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Messing <i>Brass</i>
Kontaktbelastbarkeit <i>Contact Rating</i>	50mA, 12V _{DC} <i>50mA, 12V_{DC}</i>
Kontaktfläche <i>Contact Surface</i>	Versilbert <i>Silver plated</i>
Oberfläche Lötanschluss <i>Plating Solder Side</i>	Versilbert <i>Silver plated</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 100 mΩ at initial state <i>< 100 mΩ at initial state</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 100 MΩ im Auslieferungszustand <i>> 100 MΩ at initial state</i>
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	250 V AC <i>250 V AC</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-20 °C ... +70 °C <i>-20 °C ... +70 °C</i>
Mechanische Lebensdauer <i>Mechanical Life</i>	min. 100 000 Schaltvorgänge <i>min. 100 000 operations</i>
Verarbeitung <i>Processing</i>	Reflow-Lötverfahren <i>Reflow soldering</i>



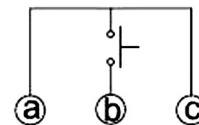
© W+P PRODUCTS



P.C.B. Layout



CIRCUIT DIAGRAM



Series	Height	Force	Locating Pegs	Packaging*
515	1 1 H=3.40mm	30 30 160g±30	10 10 Mit Pos.hilfen With loc. pegs	TR 00 TR

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** - please replace by your specifications.

Lieferformen / Packaging Options:

- 00 Schüttgut / Bulk goods
- TR Tape & Reel (Option) / Tape & Reel (Option)

Informationen zum kurzen Reflow-Lötverfahren

Fast Profile Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150°C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	120-150s
Temperatur Lötbereich T_L	230°C
Verweildauer oberhalb T_L	60s max.
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 1,5°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C max.
Dauer Höchsttemperatur	5-10s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	3°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 4,5min

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150°C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	120-150s
Soldering Range Temperature T_L	230°C
Duration above T_L	60s max.
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 1.5°C / s
Peak Temperature T_P	260°C max.
Duration Peak Temperature	5-10s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	3°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	Max. 4.5min

